

2025-2031年中国半导体设备产业发展现状与市场全景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2025-2031年中国半导体设备产业发展现状与市场全景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202501/476969.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2025-2031年中国半导体设备产业发展现状与市场全景评估报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：半导体设备行业概念界定及发展环境剖析

1.1 半导体设备的概念界定及统计口径说明

1.1.1 半导体及半导体设备界定

(1) 半导体

(2) 半导体设备的概念界定

1.1.2 半导体设备的分类

1.2 半导体设备专业术语说明

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

1.4.1 本报告权威数据来源

1.4.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章：中国半导体设备行业宏观环境分析（PEST）

2.1 半导体设备行业政策环境分析

2.1.1 行业监管体系及机构

(1) 中国半导体设备产业主管部门

(2) 中国半导体设备产业自律组织

2.1.2 行业规范标准体系建设现状

(1) 中国半导体设备产业标准体系建设

(2) 中国半导体设备产业相关标准统计

2.1.3 行业发展相关政策汇总及解读

2.1.4 十四五规划对半导体设备产业发展的影响

(1) 集成电路政策红利为半导体设备保驾护航

(2) “十四五”规划加速半导体设备国产化进程

2.1.5 政策环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.2 半导体设备行业经济环境分析

2.2.1 宏观经济现状

- (1) 中国GDP发展分析
- (2) 中国工业经济运行分析
- (3) 中国生产者价格指数 (PPI)
- (4) 中国固定资产投资分析

2.2.2 宏观经济展望

- (1) 国际机构对中国GDP增速预测
- (2) 国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 经济环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.3 半导体设备行业社会环境分析

2.3.1 中国人口规模及城镇化水平

- (1) 中国人口规模及增速
- (2) 中国城镇化水平变化

2.3.2 中国电子信息产业发展

- (1) 电子信息制造业发展现状分析
- (2) 电子信息行业前景与趋势分析

2.3.3 研发经费投入增长

2.3.4 其他相关社会因素

- (1) 集成电路严重依赖进口
- (2) 消费电子近年持续增长

2.3.5 社会环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.4 半导体设备行业技术环境分析

2.4.1 半导体行业技术迭代历程

2.4.2 存储芯片制程演进

- (1) 存储芯片结构演变
- (2) 对半导体设备的影响

2.4.3 半导体工艺技术路径朝多种路径3D化发展

2.4.4 相关专利的申请情况分析

- (1) 半导体设备专利申请数情况
- (2) 半导体设备行业专利申请人分析
- (3) 半导体设备行业热门申请专利分析

2.4.5 半导体设备行业技术发展趋势

2.4.6 技术环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.5 半导体设备行业发展机遇与挑战

第3章：半导体行业发展及半导体设备的地位分析

3.1 全球半导体行业发展分析

3.1.1 全球半导体行业发展现状概述

3.1.2 全球半导体行业市场规模

3.1.3 全球半导体行业产品结构分析

3.1.4 全球半导体行业区域发展分析

3.1.5 全球半导体行业发展趋势分析

3.2 中国半导体行业发展分析

3.2.1 半导体行业整体发展情况

(1) 市场规模

(2) 市场结构

(3) 应用领域

3.2.2 半导体设计业发展

(1) 半导体设计业市场规模

(2) 半导体设计业企业格局

(3) 半导体设计业区域竞争

(4) 半导体设计业市场结构

3.2.3 半导体制造业发展

(1) 半导体制造业生产情况

(2) 半导体制造业市场规模

(3) 半导体制造业企业竞争

(4) 半导体制造业区域竞争

3.2.4 半导体封装测试业发展

(1) 半导体封装测试业市场规模

(2) 半导体封测业区域竞争

(3) 半导体封测业企业竞争

3.2.5 中国半导体行业发展趋势分析

(1) 中国半导体行业发展趋势

(2) 中国半导体行业发展前景预测

3.3 半导体设备在半导体行业中的位置

3.4 半导体设备对半导体行业发展的影响分析

第4章：全球半导体设备行业发展现状及趋势前景分析

4.1 全球半导体设备行业发展现状分析

4.1.1 全球半导体设备行业发展历程

4.1.2 全球半导体设备行业发展现状

(1) 市场规模

(2) 市场结构

(3) 细分产品结构

4.1.3 全球半导体设备行业竞争格局分析

(1) 区域竞争

(2) 品牌竞争

4.2 全球主要区域半导体设备行业发展现状分析

4.2.1 全球半导体产业转移状况

4.2.2 韩国半导体设备行业发展分析

(1) 韩国半导体行业发展情况

(2) 韩国半导体设备行业发展情况

4.2.3 北美半导体设备行业发展分析

(1) 北美半导体行业发展情况

(2) 北美半导体设备行业发展情况

4.2.4 日本半导体设备行业发展分析

(1) 日本半导体行业发展情况

(2) 日本半导体设备行业发展情况

4.3 全球半导体设备主要企业发展分析

4.3.1 应用材料 (Applied Materials , Inc.)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

4.3.2 泛林半导体 (Lam Research)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

4.3.3 荷兰ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

4.3.4 东京电子 (TEL)

(1) 企业基本情况介绍

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业半导体设备业务发展情况

(4) 企业在华业务布局

4.4 全球半导体设备行业发展趋势及经验借鉴

4.4.1 全球半导体设备行业发展趋势分析

4.4.2 全球半导体设备行业发展的经验借鉴

第5章：中国半导体设备行业发展现状分析

5.1 中国半导体设备行业发展概述

5.1.1 半导体设备行业发展历程分析

5.1.2 半导体设备行业市场特征分析

5.2 中国半导体设备行业进出口市场分析

5.2.1 中国半导体设备行业进口市场分析

(1) 半导体设备行业整体进口情况

(2) 前道半导体设备进口分析

(3) 晶圆制造设备进口分析

(4) 封装辅助设备进口分析

5.2.2 中国半导体设备行业出口市场分析

5.3 半导体设备行业国产化进程分析

5.3.1 半导体设备行业国产化进程

(1) 中国半导体设备整体国产化情况

(2) 中国半导体设备细分产品国产化情况

5.3.2 厂商突破新领域加速推进国产化进程

5.4 中国半导体设备行业在全球地位分析

- 5.4.1 半导体设备行业市场规模分析
- 5.4.2 中国半导体设备市场规模占全球比重
- 5.5 中国半导体设备市场供需状况分析
 - 5.5.1 中国半导体设备参与者类型及规模
 - (1) 中国半导体设备参与者类型
 - (2) 中国半导体设备参与者规模
 - 5.5.2 中国半导体设备供给水平
 - (1) 晶圆制造厂商半导体设备中标地区分布
 - (2) 晶圆制造厂商半导体设备中标厂商分布
 - 5.5.3 中国半导体设备需求状况
- 5.6 中国台湾地区半导体设备行业发展分析
 - 5.6.1 中国台湾地区半导体行业发展情况
 - (1) 中国台湾地区半导体产业规模
 - (2) 中国台湾地区半导体产业特征
 - 5.6.2 中国台湾地区半导体设备行业发展情况
 - (1) 中国台湾地区半导体设备市场发展现状
 - (2) 中国台湾地区半导体设备市场发展趋势
- 5.7 中国半导体设备行业发展痛点分析

第6章：半导体设备行业竞争状态及竞争格局分析

- 6.1 半导体设备行业投资、兼并与重组分析
 - 6.1.1 行业融资现状
 - 6.1.2 行业兼并与重组
- 6.2 半导体设备行业波特五力模型分析
 - 6.2.1 现有竞争者之间的竞争
 - 6.2.2 行业潜在进入者威胁
 - 6.2.3 行业替代品威胁分析
 - 6.2.4 行业供应商议价能力分析
 - 6.2.5 行业购买者议价能力分析
 - 6.2.6 行业竞争情况总结
- 6.3 中国半导体设备行业企业竞争格局分析
- 6.4 中国半导体设备行业全球竞争力分析

第7章：中国半导体设备行业细分市场分析

- 7.1 中国半导体设备行业构成分析
- 7.2 中国半导体薄膜沉积设备行业发展分析
 - 7.2.1 半导体薄膜沉积工艺概述
 - 7.2.2 半导体薄膜沉积技术发展分析
 - (1) CVD技术工艺
 - (2) PVD技术
 - (3) ALD技术
 - 7.2.3 半导体薄膜沉积设备发展现状分析
 - (1) 半导体薄膜沉积设备市场规模分析
 - (2) 半导体薄膜沉积设备竞争格局
 - (3) 半导体薄膜沉积设备国产化现状
 - 7.2.4 半导体薄膜沉积设备发展趋势分析
- 7.3 中国半导体光刻设备行业发展分析
 - 7.3.1 半导体光刻工艺概述
 - 7.3.2 半导体光刻技术发展分析
 - (1) 光刻技术原理
 - (2) 光学光刻技术
 - (3) EUV光刻技术
 - (4) X射线光刻技术
 - (5) 纳米压印光刻技术
 - 7.3.3 半导体光刻机发展现状分析
 - (1) 光刻机工作原理
 - (2) 光刻机发展历程
 - (3) 光刻机市场规模
 - (4) 光刻机竞争格局
 - (5) 光刻机国产化现状
 - 7.3.4 半导体光刻设备发展趋势分析
- 7.4 中国半导体刻蚀设备行业发展分析
 - 7.4.1 半导体刻蚀工艺概述
 - 7.4.2 半导体刻蚀工艺发展情况
 - (1) 主要刻蚀工艺分类
 - (2) 刻蚀工艺演进现状

7.4.3 半导体刻蚀设备发展现状分析

- (1) 刻蚀设备市场规模
- (2) 刻蚀设备竞争情况
- (3) 刻蚀机国产化现状

7.4.4 半导体刻蚀设备发展趋势分析

- (1) 技术进步为刻蚀设备市场带来巨大增量
- (2) 先进制程与存储技术推动刻蚀设备投资增加
- (3) 刻蚀精度要求提升，推动ICP刻蚀设备占比提升

7.5 中国半导体清洗设备行业发展分析

7.5.1 半导体清洗工艺概述

7.5.2 半导体清洗技术发展分析

- (1) 半导体清洗技术分类
- (2) 半导体清洗技术——湿法清洗
- (3) 半导体清洗技术——干法清洗

7.5.3 半导体清洗设备发展现状分析

- (1) 半导体清洗设备分类
- (2) 半导体清洗设备市场规模
- (3) 半导体清洗设备竞争格局
- (4) 半导体清洗设备国产化现状

7.5.4 半导体清洗设备发展趋势分析

- (1) 芯片先进制程迭代促进清洗设备规模扩容
- (2) 国产化进程将进一步加快

7.6 中国半导体封装设备行业发展分析

7.6.1 半导体封装工艺概述

7.6.2 半导体封装技术发展分析

7.6.3 半导体封装设备发展现状分析

- (1) 全球及中国封装设备市场规模
- (2) 封装设备竞争格局
- (3) 封装设备国产化现状

7.6.4 半导体封装设备发展趋势分析

7.7 中国半导体测试设备行业发展分析

7.7.1 半导体测试工艺概述

7.7.2 半导体测试技术发展分析

7.7.3 半导体测试设备发展现状分析

- (1) 测试设备分类
- (2) 全球及中国测试设备市场规模
- (3) 测试设备竞争格局
- (4) 测试设备国产化

7.7.4 半导体测试设备发展趋势分析

- (1) 5G、汽车和物联网需求推动测试设备需求增长
- (2) 国产化进程进一步加快

7.8 中国半导体制造其他设备发展分析

7.8.1 单晶炉设备

- (1) 设备简介
- (2) 生产工艺
- (3) 单晶炉投料情况
- (4) 国内代表厂商情况

7.8.2 氧化/扩散设备

- (1) 设备简介
- (2) 市场规模
- (3) 企业竞争情况
- (4) 国内代表厂商情况

7.8.3 离子注入设备

- (1) 设备简介
- (2) 市场规模
- (3) 竞争情况

第8章：中国半导体设备行业领先企业生产经营分析

8.1 半导体设备行业代表企业概况

8.2 半导体设备行业代表性企业案例分析

8.2.1 北方华创科技集团股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.2 中微半导体设备（上海）股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.3 拓荆科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业销售网络分析

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业融资历程

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.4 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

(1) 企业基本信息简介

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及主要客群

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.5 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体设备业务布局

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.6 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.7 北京屹唐半导体科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业融资历程
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.8 上海微电子装备（集团）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业融资历程
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.9 中国电子科技集团有限公司

- (1) 企业发展基本信息及组织架构
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.10 北京华卓精科科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.11 北京华峰测控技术股份有限公司

- (1) 企业基本信息简介
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

8.2.12 杭州长川科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备相关产销状况
- (6) 企业半导体设备业务研发动向
- (7) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

第9章：中国半导体设备行业发展前景预测与投资机会分析

9.1 半导体设备行业投资潜力分析

9.1.1 行业生命周期分析

9.1.2 行业发展潜力分析

9.2 半导体设备行业发展前景预测

9.2.1 半导体设备行业发展趋势

9.2.2 半导体设备行业发展前景预测

9.3 半导体设备行业投资特性分析

9.3.1 行业进入壁垒分析

9.3.2 行业投资风险预警

9.4 半导体设备行业投资价值与投资机会

9.4.1 行业投资价值分析

9.4.2 行业投资机会分析

9.5 半导体设备行业投资策略与可持续发展建议

9.5.1 行业投资策略分析

9.5.2 行业可持续发展建议

图表目录

图表1：半导体分类结构

图表2：半导体与集成电路、芯片的关系图

图表3：半导体分类简介

图表4：芯片制造产业链

图表5：半导体设备的分类

图表6：半导体设备专业术语说明

图表7：本报告研究范围界定

图表8：本报告权威数据资料来源汇总

图表9：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表10：中国半导体设备行业监管体系

图表11：中国半导体设备产业主管部门

图表12：中国半导体设备产业自律组织

图表13：中国半导体设备产业标准体系建设

图表14：截至2024年中国半导体设备行相关标准汇总

图表15：截至2024年7月半导体设备行业发展政策汇总及解读

图表16：政策环境对半导体设备产业发展的影响总结

图表17：2020-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表18：2020-2024年中国全部工业增加值及增速（单位：万亿元，%）

图表19：2020-2024年中国PPI变化情况（单位：%）

图表20：2020-2024年中国固定资产投资额（不含农户）及增速（单位：万亿元，%）

图表21：部分国际机构对2024年中国GDP增速的预测（单位：%）

图表22：2024年中国宏观经济核心指标预测（单位：%）

图表23：2020-2024年中国人口规模及自然增长率（单位：万人，‰）

图表24：2020-2024年中国城镇人口规模及城镇化率（单位：万人，%）

图表25：2020-2024年电子信息制造业累计增加值和累计出口交货值增速（单位：%）

图表26：2020-2024年电子信息制造业营业收入、利润增速变动情况（单位：%）

图表27：2020-2024年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况（单位：%）

图表28：2020-2024年中国研究与试验发展（R&D）经费投入及增速情况（单位：亿元，%）

图表29：2020-2024年中国研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与GDP之比）情况（单位：%）

图表30：2020-2024年中国集成电路行业进口贸易规模和进口数量（单位：亿美元，亿个）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202501/476969.html>